



平成24年2月2日

各 位

上場会社名：株式会社東京精密
代表者名：代表取締役社長 太田 邦正
(コード番号 7729 東証第1部)
問合せ先：取締役業務会社執行役員社長
川村 浩一
(TEL 042-642-1701)

「精密ブレード事業譲受」に関する三菱マテリアル株式会社との基本合意について

当社は、本日開催の取締役会において、三菱マテリアル株式会社の精密ブレード製品(*)に関する事業を譲受けることについて、同社と基本合意書を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 事業譲受の背景と目的

当社は、これまで最先端技術を活用したダイシング装置を提供し、お客様のダイシングニーズに応じてきましたが、近時、お客様の各種アプリケーションニーズはますます高度化・多様化が進んでいます。

このような事業環境下、装置のみならず装置およびブレードの両面からの対応が重要であると認識し、三菱マテリアル株式会社と当社精密ブレード事業の譲渡について検討を重ねてきた結果、今般、同事業を譲受けることに関し、基本合意に至りました。

当社は、同社がこれまで培ってきた技術・ノウハウ等を引き継ぐことにより、お客様へのニーズ対応力を飛躍的に高めるとともに、装置・ブレード双方の事業の一層の拡大を図っていく所存です。

2. 今後のスケジュール

平成24年5月30日：事業譲渡契約締結(予定)

平成24年7月1日：事業譲渡(予定)

3. 相手先【三菱マテリアル株式会社】の概要

本社所在地：東京都千代田区大手町1-3-2

代表者：取締役社長 矢尾 宏

資本金：1,194億57百万円(平成23年3月末)

主な事業：セメント、銅・金・銅加工品、超硬製品・高機能製品、機能材料・電子デバイス製品・多結晶シリコン、飲料用アルミ缶・アルミ圧延・加工品等の製造・製錬・加工・販売等

4. 業績への影響

本件事業譲受による当社への業績影響は軽微であります。

(*) 精密ブレード製品とは、おもに電気製品や電子機器に組み込まれるセラミックスコンデンサー、LEDパッケージ、各種ICパッケージ等の電子部品や半導体を一個一個に切り分けるための工業用ダイヤモンドを用いた精密切断刃。

以上